公司代码:688798　　公司简称:艾为电子　转债代码:118065 转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 731,977,548.16 元;公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 317,009,892.40 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 233,128,636 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 100,245,313.48 元(含税)。本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 31.62%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	艾为电子	688798	不适用	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余美伊	余美伊
联系地址	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层	上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
电话	021-52968068	021-52968068
传真	021-64952766	021-64952766
电子信箱	securities@awinic.com	securities@awinic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

(1)主营业务的基本情况

公司是一家专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链的集成电路设计企业,主营业务为集成电路芯片研发和销售。截至报告期末,公司主要产品型号达 1,700 余款,2025 年度产品销量接近 57 亿颗,可广泛应用于消费电子、工业互联、汽车领域。

随着持续演进与应用场景的深度融合,用户对产品体验的要求不断提升。消费电子产品对声音效果、能源功耗、通信传输、触觉反馈和对焦防抖等方面的性能需求不断提升,推动新一代智能硬件向更复杂、更精密、更高效的方向发展,也对支撑其功能实现的芯片提出了更高、更精细的技术要求。公司在高性能数模混合信号、电源管理、信号链领域深耕多年,始终紧跟市场趋势,持续开展技术攻关与产品创新,逐步拓展产品矩阵。依托扎实的技术积累与持续的研发投入,公司已建立起跨领域的技术竞争力,相关解决方案不仅适用于消费电子,也广泛应用于工业互联、汽车等其他领域。通过不断推出符合国产化替代需求的高性能芯片,公司致力于为客户提供可靠的技术支持,推动产业链自主创新与升级。

在高性能数模混合信号芯片领域,公司积累了深厚的技术底蕴,并构建起完整的产品系列。目前,已打造出完善的音频解决方案,涵盖硬件芯片与软件算法的深度融合;推出集成 Haptic 硬件与 TikTap 触觉反馈系统的整体方案;提供用于摄像头高精度光学防抖的 OIS 芯片及配套防抖算法;开发多通道压力检测 SOC 芯片与高精度压力识别算法;并成功量产压电微泵液冷驱动芯片。在电源管理芯片与信号链芯片方向,公司持续扩充产品品类,积极拓展下游应用市场。其中,音频功放芯片与马达驱动芯片已较早实现技术突破与产品系列化布局,在国内同行业中建立起显著的先发优势与产品竞争力。

公司产品以新智能硬件为核心应用方向,凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量与细致的客户服务,已进入众多行业领先企业的供应链体系。公司的客户涵盖消费电子品牌如小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想;汽车品牌包括比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑;以及全球科技企业如微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等。同时,公司也与华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等头部 ODM 厂商建立了长期稳定的合作关系。在此基础上,公司持续深耕细分市场,在可穿戴设备、智能便携终端、AIoT、工业控制及汽车电子等领域,不断拓展与各领域头部客户的合作深度与广度,推动产品在多元场景下的落地应用。

(2)主要产品和业务情况

公司产品在技术领域覆盖数模混合信号、模拟、射频芯片,主要产品包括高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片等。报告期末,公司已有 1,700 余款产品型号,应用于消费电子、物联网、工业、汽车领域,并在各类电子产品中具有较强的拓展性和适用性,具体情况如下:

产品分类	主要产品	主要及可应用领域
高性能数模混合芯片	数字智能 K 类音频功放;智能 K 类音频功放;K 类音频功放;D 类音频功放;AB 类音频功放;高性能 NFU 智能语音芯片,音频 ADC,车载音频功放;触觉反馈芯片;OIS 光学防抖 SoC 芯片;VCM 对焦马达驱动;压力感应 SoC/AFE 芯片;压电微泵液冷驱动芯片;电容感应 SoC/AFE 芯片;SAR 感应 SoC 芯片;声光同步呼吸灯驱动 SoC 芯片等	手机、AIoT、工业、汽车、智能音箱、可穿戴设备、便携式音频设备、共享单车、智能玩具、智能家具、智能家居、游戏设备、元宇宙、笔记本电脑、智慧安防、智能锁、机器人、家电等
电源管理芯片	背光灯驱动;呼吸灯驱动;闪光灯 / 红外灯驱动;ToF LD 驱动;过压保护 OVP;过流保护 OCP;线性充电芯片;大功率快速充电芯片;DCDC 开关电源;LCD Bias;Amoled Power;LDO;负载开关;端口保护开关;PD 协议芯片;CC 逻辑识别芯片;直流马达驱动;步进马达驱动;MOS 等	手机、AIoT、工业、汽车、平板、笔记本、智能音箱、POS 机、电动单车、可穿戴设备、智能玩具、物联网、三表、智慧安防、变频器、逆变器、服务器、电动工具、电子烟、医疗电子等
信号链芯片	射频开关;天线调谐开关;GNSS 低噪声放大器;FM 低噪声放大器;4G/5G 低噪声放大器;霍尔传感器芯片;信号检测 AFE;运算放大器;比较器;高速开关;模拟开关;电平转换;接口芯片;复位芯片等	手机、AIoT、工业、汽车、平板、可穿戴设备、智能音箱、POS 机、通信设备、定位器等

主要产品基本情况:

1. 高性能数模混合信号芯片

经过数年的开发积累,公司在高性能数模混合信号芯片上布局丰富。高性能数模混合信号包括音频功放芯片、触觉反馈芯片、OIS 光学防抖 SoC 芯片、压力感应 SoC/AFE 芯片、电容感应 SoC 芯片、SAR 感应 SoC 芯片、声光同步呼吸灯驱动 SoC 芯片等。

音频功放芯片主要应用于手机等多媒体播放设备的音频信号放大,其功能为放大来自音源或前级放大器输出的弱信号,并驱动播放设备发出声音。音频功放芯片是多媒体播放设备的核心部件,决定了播放设备的音质与功耗,并且随着音频功放技术的发展,音频功放芯片逐步从模拟芯片演进到数模混合信号芯片,通过算法智能优化化音频输出,进一步提升了音质和效果,同时对芯片和扬声器提供保护。公司的音频功放芯片主要包括数字智能 K 类、智能 K 类、K 类、D 类和 AB 类等覆盖不同功率及应用场景的产品,其中 K 类功放,其芯片规格和引脚定义均为公司自主原创,引领了市场潮流。

SAR 感应 SoC 芯片应用于手机等无线电子设备的人体靠近检测,当人体靠近电子设备时,会通知设备主控降低 RF 功率以减少 RF 对人体的辐射伤害,保障无线设备通过 SAR 标准认证。随着各个国家和地区的 SAR 标准强制执行,公司自主研发了一系列高性能 SAR 感应 SoC:第一代高灵敏度系列、第二代 Flash 可编程系列和第三代自适应温度补偿系列,SAR 感应 SoC 已经成熟量产。

LIN RGB 汽车氛围灯驱动 SoC 应用于汽车智能座舱氛围灯控制,赋能汽车智能座舱更具有美感和科技感,提升用户的驾乘体验。公司自主研发了首款高性能 LIN RGB 氛围灯驱动 SoC 产品,该产品高度集成了 LIN PHY、低功耗 MCU、高压恒流驱动等丰富的外设资源,同时内置颜色校正、灯珠温度补偿等专业算法,为车载氛围灯应用提供优异的单芯片解决方案。

Haptic 触觉反馈,是指通过软硬件结合的触觉反馈机制,模拟人与自然的真实触觉体验;公司在 2017 年即推出了自主创新的高压 Haptic 产品,并持续推动 Haptic 技术在手机、AIoT、笔电、车载智能表面等市场快速普及;公司触觉反馈芯片主要包括 Boost 升压、Charger Pump 升压、常压等覆盖不同功率及应用场景的产品,均为公司自主原创。

OIS 光学防抖,是指通过马达推动可移动式的部件,对由于握持抖动产生的光路变化进行补偿,从而实现减轻照片模糊的效果;公司 OIS 光学防抖芯片主要包括:分立式 OIS、集成式 OIS、SMA OIS、Piezo OIS 等。

2. 电源管理芯片

电源管理芯片是一种在电子设备中承担电能变换、分配和监控的芯片,其功能一般包括电压转换、电流控制、电池管理、低压差稳压、电源选择、动态电压调节、电源开关时序控制、LED 驱动、直流 / 步进马达驱动等。电源管理芯片的性能和可靠性对电子产品的性能和可靠性有着直接影响,是电子设备中的关键器件,并在几乎所有的电子产品和设备中广泛运用,是模拟芯片最大的细分市场之一。

公司电源管理芯片主要包括 LED 驱动、端口保护、负载开关、低压差稳压、电压转换、电池管理、马达驱动、MOS 等芯片。其中 LED 驱动芯片细分为背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动,马达驱动包括步进马达驱动、直流电动机驱动等芯片产品。公司积极把握电源管理芯片在智能手机及新智能硬件产品的运用,凭借长期的技术积累和高效的研发能力,在电源管理芯片领域持续推出新产品,从智能手机为核心的新智能硬件出发,并快速延展至 AIoT、工业、汽车等领域,并结合创新能力形成了独具特色的优势产品,获得了下游终端企业的认可和应用。

3. 信号链芯片

信号链芯片是连接真实世界和数字世界的桥梁,是一种对信号进行采集、放大、传输的器件。

公司信号链芯片主要包括运放、比较器、模拟开关、高速开关、电平转换、射频前端、开关霍尔、线性霍尔等。其中射频前端芯片主要包括射频开关、低噪声放大器、调谐开关、FEM 等,用于实现射频信号接收与发射或不同频段间的切换、接收通道的射频信号放大、发射通道的射频信号放大等。公司积极把握信号链芯片在智慧工业、智慧社区、智慧安防、智能汽车等领域的高速成长,凭借雄厚的技术积累和高效的产品开发能力,快速推出匹配市场需求的产品,获得了多个细分领域头部终端客户的认可和应用。

2.2 主要经营模式

集成电路企业采用的经营模式一般可以分为 IDM 模式和 Fabless 模式。采用 IDM 模式的企业可以独立完成芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节工作。采用 Fabless 模式的企业专注于芯片的研发设计与销售,将晶圆制造、封装、测试等生产环节委托第三方晶圆制造和封装测试企业完成。随着终端产品的应用需求日益多元化,芯片设计难度快速提升,研发资源和成本持续增加,促使全球集成电路产业分工细化,Fabless 模式已成为芯片设计企业的主流经营模式之一。公司目成立以来,始终采用 Fabless 的经营模式。

集成电路行业经营模式

1. 研发模式

公司根据产品特点,采用集成产品开发和项目管理方法,制定各款产品的设计开发流程,以控制产品开发质量,保证产品开发进度,提升产品核心竞争力。公司产品的设计开发流程分为立项、概念、计划、设计、验证、生命周期六大阶段,其中立项阶段主要对新项目的可行性进行评审,以确认是否需启动项目研发;概念阶段主要由项目经理组织协调各部门成员进行市场调查、产品策划、技术可行性分析、财务分析、确定初步规格以及知识产权分析后,出具概念可行性报告进行评审;计划阶段需要确认工艺厂家和封装测试要求,细化产品规格,完成全面的知识产权检索分析,判断项目中存在的风险,并提前采取措施防范风险;设计阶段主要是以技术研发为主体的产品设计开发阶段,对产品的性能、质量等进行改良与创新;验证阶段主要对设计出的产品进行产品验证,评估产品与设计预期的相符情况,是否满足量产条件;产品生命周期主要为产品验证通过后开始量产,并获得下游应用市场的使用,直至逐渐被新产品所取代。

公司产品的设计开发流程图

2. 采购和生产模式

公司专注于集成电路设计,主要采用 Fabless 模式,不直接参与芯片的生产环节,通过委托第三方晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试。公司将自主设计的芯片委托晶圆厂商生产晶圆,再将晶圆委托封测厂商进行封测加工,最终形成芯片产品。在该过程中,公司将采购自主定制化设计的晶圆和封装测试加工服务。为了保证最终产品质量,公司建立了严格的供应商评估、日常管理流程和采购核价体系。报告期内,公司主要供应商为全球知名的晶圆制造和封装测试厂商。

3. 销售模式

结合行业惯例和客户的采购习惯,公司目前采用经销为主、直销为辅的销售模式,即公司通过经销商销售产品,也向终端厂商直接销售产品。在经销模式下,公司与经销商属于买断式销售;在直销模式下,公司直接将产品销售给终端客户。

(1)经销模式

公司产品种类繁多,应用领域广泛,采用经销为主的销售模式是行业内较为通行的销售模式,经销商可协助芯片设计公司更有效地拓展市场,使公司开发的产品与终端客户的产品快速结合。同时经销商承担着维护日常客户关系、提供货物运输和资金周转的重要角色,是 IC 产业链中不可或缺的纽带。

公司通过比较信誉、资金实力、终端客户需求、市场影响力、客户服务水平等因素,结合客户采购习惯及需求,择优选择优质经销商,与经销商保持了合作共赢、共同发展的良好态势。公司通过对接国内外知名的电子元器件经销商,与知名品牌终端企业保持了稳定的合作关系。

(2)直销模式

基于终端客户的采购管理体系及原材料采购需求,部分客户选择向公司直接采购芯片产品。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业发展情况

公司所处行业为半导体集成电路行业,集成电路行业从处理信号的形式上划分,可分为模拟集成电路和数字集成电路,模拟集成电路处理的是连续函数形式模拟信号的集成电路,数字集成电路是对离散数字信号进行算术和逻辑运算的集成电路。集成电路行业是全球电子信息产业的基础,经过多年的发展,已经形成了相对成熟的产业分工,分别是:设计业,晶圆制造业,封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业是衔接终端客户和晶圆制造、封装测试的桥梁,集成电路设计企业在发展过程中,可以与上游制造企业形成工艺创新、设计创新;可以与终端客户形成设计创新、应用创新,使得集成电路设计企业成为集成电路行业的“发动机”。

根据美国半导体行业协会(SIA)的数据显示,2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元,相比 2024 年的 6,305 亿美元,同比增长 25.6%。行业年度销售额由此创下历史新高,同时,SIA 预测 2026 年全球半导体销售额有望达到约 1 万亿美元。作为现代科技的基石,半导体需求持续受到人工智能、物联网、6G 及自动驾驶等前沿技术的强劲拉动。本轮半导体需求的增长已超越了传统的行业周期模式,展现出结构性的新特征。增长动力不再单一依赖消费电子,而是转向以人工智能与数据中心为核心的全新引擎。行业预测显示,2026 年仅北美主要云服务商在 AI 基础设施领域的投资就将高达 6,000 亿美元,这些投资将集中于 AI 芯片、高带宽存储及大规模算力集群,从而直接且持续地驱动上游半导体需求。与此同时,边缘 AI 计算、汽车电子化与工业智能化的多场景融合与快速渗透,也为半导体产业的长期增长提供了多元而坚实的支撑。

(2)公司产品主要应用领域行业发展情况

智能手机领域,根据国际数据公司(IDC)发布的数据,2025 年全球智能手机市场在关税波动、供应链扰动及宏观经济压力等多重挑战下,仍实现了温和增长,出货量达到 12.6 亿部,同比增长 1.9%。与此同时,中国市场的表现略有回调。2025 年全年,中国智能手机出货量约为 2.95 亿台,同比微降 0.6%。展望 2026 年,全球智能手机市场环境预计将发生变化,行业普遍担忧的存储芯片短缺问题,可能导致全球智能手机出货量出现下滑。

个人电脑(PC)领域,根据市场研究机构 Gartner 的统计,2025 年全球个人电脑(PC)市场呈现显著复苏,出货量超过 2.7 亿台,同比增长 9.1%。这一增长主要由企业端换机需求集中释放、消费市场保持稳健,以及 PC 厂商将 AI PC 作为营销重点等三方面因素所驱动。

平板电脑领域,根据市场研究机构 Omdia 的数据,2025 年全球平板电脑出货量达到 1.62 亿台,同比增长 9.8%。展望 2026 年,平板市场需求预计将因内存供应紧张而承压,增长机会将更集中于高端旗舰机型的换机周期以及新兴市场由公共部门推动的教育需求。从产品策略看,厂商正进一步将平板定位为生态系统核心设备,通过引入跨系统协同功能与 AI 增强体验,在日益挑战的市场环境中开辟新的差异化增长路径。

可穿戴设备领域,根据国际数据公司(IDC)发布的数据,2025 年全球可穿戴设备出货量达到 6.12 亿部,同比增长 9.1%。展望 2026 年,虽然用于消费电子的通用内存供应受限、价格普涨,可能会推高可穿戴设备的制造成本,并影响中低端产品的定价与供应稳定性;但厂商正加速将可穿戴设备深度整合至健康管理、运动生态与智能家居场景中,通过强化传感器精度、引入 AI 健康洞察与跨设备协同功能,以吸引新用户、提升市场渗透率并开拓新的增长机会。

智能眼镜领域,根据国际数据公司(IDC)发布的数据,2025 年全球智能眼镜出货量达到 1,452 万部,同比增长 425%。展望 2026 年,全球智能眼镜出货量有望突破 3,500 万部,同比增长 141.0%。这一市场规模的加速扩张主要得益于以下驱动因素:首先,Meta Ray-Ban 等产品的商业成功已初步验证市场接受度;其次,Google、Samsung 等科技巨头计划入场,预计将带来更强的品牌号召力与生态整合效应;最后,视觉 AI 应用(如实时翻译、导航、情境搜索)日益成熟,正推动配备显示屏(HUD)的智能眼镜迈向主流。随着技术持续成熟、价格逐步下探以及应用场景不断拓展,智能眼镜已逐渐摆脱小众科技玩具的定位,向大众 AI 设备演进,2026 年或将成为该

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2026-028
转债代码:118065　转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●为持续提升上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)创新能力和技术水平,并基于长期发展战略与战略布局的考量,结合核心技术人员岗位职责变化,公司对核心技术人员构成进行优化调整,原核心技术人员继续留任并在其他岗位发挥重要作用。

●截至本公告披露日,公司的技术研发工作有序推进。本次核心技术人员的调整不会对公司的技术研发、生产经营等方面产生任何不利影响。

一、本次核心技术人员调整的具体情况

为持续提升公司创新能力和技术水平,并基于长期发展战略与战略布局的考量,结合核心技术人员岗位职责变化,公司原核心技术人员程剑涛先生、张忠先生不再被认定为核心技术人员,但仍继续在公司任职;同时新增认定吴绍夫先生和姚炜先生为公司核心技术人员。

(一)原核心技术人员的具体情况

1、程剑涛先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 7 月,任珠海亚力电子有限公司研发部模拟电路设计工程师;1999 年 8 月至 2002 年 4 月,历任华为技术有限公司中央研究部模拟电路设计工程师、项目经理、产品经理;2002 年 5 月至 2008 年 5 月,历任启攀微电子(上海)有限公司研发部项目经理、产品经理;2008 年 6 月至 2014 年 12 月,任艾为有限科技总监;2014 年 12 月至 2024 年 2 月,任公司董事;2014 年 12 月至今,历任公司技术副总裁、技术专家。

截至本公告披露日,程剑涛先生直接持有公司 7,464,635 股股份。本次核心技术人员调整后,程剑涛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。

2、张忠先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990 年 8 月至 1998 年 2 月,历任无锡市华晶电子集团公司中央研究所助理工程师、工程师;1998 年 3 月至 2002 年 7 月,历任华为技术有限公司中研基础部芯片设计高级工程师、项目经理;2002 年 8 月至 2008 年 9 月,历任威讯联华电子(上海)有限公司项目经理、产品经理;2008 年 10 月至 2014 年 12 月,任艾为有限研发部副部长、高级技术专家;2014 年 12 月至 2020 年 9 月,任艾为电子董事;2014 年 12 月至今,历任公司研发部副部长、研发总监、首席技术专家、技术专家。

截至本公告披露日,张忠先生直接持有公司 6,196,120 股股份。本次核心技术人员调整后,张忠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。

(二)知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

(三)保密及竞业限制情况

公司与程剑涛先生、张忠先生签署了保密及竞业限制协议,对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定,并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日,公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司结合未来发展规划,综合考虑相关人员对公司核心项目研发的参与情况以及对业务发展贡献等实际情况,决定新增认定吴绍夫先生、姚炜先生为公司核心技术人员,具体情况如下:

(一)吴绍夫先生简历

吴绍夫先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998 年 3 月至 2002 年 11 月,任上海贝尔阿尔卡特有限公司工程师;2002 年 11 月至 2008 年 2 月,任 UT 斯达康通讯有限公司工程师;2008 年 2 月至 2012 年 10 月,任科缔纳网络系统(上海)有限公司开发经理;2012 年 10 月至 2025 年 11 月,任公司监事。2012 年 10 月至今,任公司研发总监。

截至本公告披露日,吴绍夫先生直接持有公司 560,250 股股份。吴绍夫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

(二)姚炜先生简历

姚炜先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 6 月,任华为技术有限公司工程师;2002 年 8 月至 2008 年 10 月,任启攀微电子(上海)有限公司工程师;2008 年 10 月至 2011 年 3 月,任科缔纳网络系统(上海)有限公司主任工程师;2011 年 3 月至今,任公司资深技术专家。

截至本公告披露日,姚炜先生直接持有公司 113,423 股股份。姚炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终将研发投入与技术人才梯队建设置于战略高度,已构建起结构完善、运行高效的研发团队与研发管理体系,打造了一支高素质、专业化的研发力量。核心技术团队具备扎实的专业理论功底与丰富的技术创新实践经验,对行业前沿技术方向及产业发展趋势拥有敏锐洞察与前瞻判断,为公司核心技术持续迭代与创新奠定提供坚实支撑。公司不存在对单一核心技术人员的重大依赖,现有研发团队及核心技术人员整体实力稳定,可有效保障未来核心技术的持续研发与技术竞争力不断提升。

本次核心技术人员变动情况如下:

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	孙洪军,郭辉,杜黎明,程剑涛,张忠
本次变动后	孙洪军,郭辉,杜黎明,吴绍夫,姚炜

四、公司采取的措施

目前,公司的研发团队结构完整,在研项目均处于正常有序地推进状态,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养,持续提升技术创新能力。

五、保荐人对核心技术人员调整的核查意见

经核查,保荐人认为:公司核心技术人员总体稳定,本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响,不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷,不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐人对公司本次核心技术人员调整事项无异议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2026-027
转债代码:118065　转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 26,449,098.69 元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币 2,224,134.49 元,合计人民币 28,673,233.18 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972 号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册,同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为 190,132.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。公司本次发行的可转换公司债券 19,013,200 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 190,132.00 万元,扣除尚未支付的保荐承销费 1,230.92 万元(不含税)后,已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司于 2026 年 1 月 28 日汇入公司募集资金监管账户,实际到账金额为 188,901.08 万元。另扣除其他发行费用 274.30 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 188,626.78 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方 / 四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转债的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额 188,626.78 万元将用于投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	全球研发中心建设项目	148,472.97	120,936.78
2	端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目	36,593.61	24,120.00
3	车载芯片研发及产业化项目	31,658.39	22,680.00
4	运动控制芯片研发及产业化项目	28,735.53	20,890.00
合计		245,460.50	188,626.78

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 5 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,449,098.69 元,公司拟置换募集资金投资金额为 26,449,098.69 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	拟置换金额
1	全球研发中心建设项目	120,936.78	1,216.19	1,216.19
2	端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目	24,120.00	663.39	663.39
3	车载芯片研发及产业化项目	22,680.00	49.40	49.40
4	运动控制芯片研发及产业化项目	20,890.00	715.93	715.93
合计		188,626.78	2,644.91	2,644.91

四、已支付发行费用的自筹资金支付情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 15,052,242.41 元,其中承销保荐费用人民币 12,309,240.00 元(不含税)已自募集资金中扣除,其他发行费用人民币 2,743,002.41 元。截至 2026 年 3 月 5 日止,公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 2,224,134.49 元,需用 2,224,134.49 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	类别	发行费用	自筹资金支付金额	置换金额
承销及保荐费用	承销费及保荐费	100.00	100.00	100.00
律师费用	律师费	79.48	41.75	41.75
会计师费用	审计及验资费	56.60	56.60	56.60
资信评级费用	登记费	14.15	–	–
信息披露及发行手续费	咨询费	24.06	24.06	24.06
合计		274.30	222.41	222.41

注:上表中发行费用不包含已自募集资金中扣除的部分。

五、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 26,449,098.69 元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,人民币 2,224,134.49 元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。

六、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

经审议,董事会审计委员会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定,严格地履行了审批程序,不存在损害股东利益的情形,同意公司置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)会计师事务所鉴证结论

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 8 日出具了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2026]第 ZA10886 号),认为:公司管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至 2026 年 3 月 5 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的审议程序,且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:688798　证券简称:艾为电子　公告编号:2026-026 转债代码:118065　转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》,综合考虑向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施情况,提高募集资金使用效率,公司决定增加可转债募投项目实施主体。本次增加实施主体未改变可转债募投项目的内容、投资用途和投资总额。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972 号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册,同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为 190,132.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。公司本次发行的可转换公司债券 19,013,200 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 190,132.00 万元,扣除尚未支付的保荐承销费 1,230.92 万元(不含税)后,已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司于 2026 年 1 月 28 日汇入公司募集资金监管账户,实际到账金额为 188,901.08 万元。另扣除其他发行费用 274.30 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 188,626.78 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方 / 四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转债的募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额 188,626.78 万元将用于投入以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)
1	全球研发中心